

 **SG6260Z 有机硅缩合压敏胶(高粘1000~1200g）**

1. 特性：SG6260Z有机硅缩合压敏胶是属于缩合型固化的一种有机硅压敏胶，具有低迁移、粘性稳定、耐湿、耐热和耐候性强，移除无“鬼影”。涂层无气泡、透明度高，电气绝缘性特性。涂之前需用打底涂。

物性指标

 外观：无色或淡黄色透明粘稠状液体

 稀释剂：甲苯或乙酯

 固含量：60%~62%

 粘度：35000-65000C.P.S

1. 配比

 SG6260Z:100

 BPO粉末: 1.5~3.0

步骤 ：

 1. B.P.O除水處理

將B.P.O與甲苯按比例稀釋（建议稀释到35%固含量）→ 攪拌溶解 → 過濾下層水分→ 用250目的濾網過濾雜質後備用（注意：確保B.P.O不含水分； B.P.O溶解提純後，需在8小時內用完）。

1. SG6733A底塗的調配

將SG6733A與SK0010C按100:1添加，攪拌30~60min備用。

3. SG6260Z壓敏膠水的調配

將SG6260Z與甲苯按一定比例稀釋→攪拌溶解（20min）→添加綠色色漿→攪拌溶解（30min）→添加預處理好的B.P.O稀釋液→搅拌均匀后过滤上机涂布。

1. 工艺
2. 实验室涂布工艺：150℃ 2-3分钟烘烤即可。
3. 生产涂布参考工艺：烘箱温度设定为依此从80℃（膠水部分）→95℃（膠水部分）→135℃（膠水部分）→165℃（膠水部分）→155℃（膠水部分）→145℃（膠水部分），烘烤时间和温度是根据涂布量来调整，当涂布的干胶厚度在10um时，胶水的烘烤时间控制在1-1.5分钟之间，当涂布的干胶厚度在20um时，胶水的烘烤时间应控制在1.5分钟以上为宜。

以上内容是根据我们的经验提供，具体使用需要根据涂布工艺的特性决定。